

厦门市集成电路产业发展工作领导小组办公室文件

厦集成电路办〔2019〕1号

厦门市集成电路产业发展工作领导小组办公室 关于申报 2019 年第一批厦门市集成电路产业 发展专项资金的通知

各有关企业：

根据《厦门市人民政府关于印发加快发展集成电路产业实施意见的通知》（厦府〔2016〕220号）、《厦门市人民政府办公厅关于印发加快发展集成电路产业实施细则的通知》（厦府办〔2018〕58号）、《厦门市人民政府办公厅关于调整加快发展集成电路产业实施细则的通知》（厦府办〔2018〕185号）等文件精神，现将 2019 年厦门市集成电路产业发展专项资金申报事项通知如下：

一、申报企业条件

注册地、经营场所均在厦门市行政辖区内的，具有独立法人资格，无违法违规行为，专业从事集成电路领域设计、制造、封测、装备和材料生产及研发，专业投融资、公共技术服务等经营活动的集成电路相关企业（单位）（以下简称集成电路企业）。

二、资金支持年度和申报时间

（一）资金支持为 2017 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日期间实施的。申报项目另外注明时间的除外。

（二）申报时间：自本通知发布之日起至 2019 年 4 月 30 日。其中，网上申报截止日期 2019 年 4 月 25 日。

三、申报材料

具体项目申报材料根据《厦门市集成电路产业发展专项资金项目申报指南》（见附件）要求提供。

四、申报程序

（一）网上申报

申报单位登陆“i 厦门一站式惠民服务平台”（<http://www.ixm.gov.cn/>）-“i 经信”-“资金类项目申报”，注册法人账号，登录后选择所要申报的项目类别，按要求填写项目申报表并根据系统所列要求上传申报材料（操作过程中如有疑问，可点击右上角“帮助”，下载“厦门市工信局一体化综合信息管理平台用户操作手册”）。

（二）提交纸质材料

网上审核通过后，申报单位于2019年4月30日之前，报送纸质材料（一式三份），纸质版须与电子版保持一致。

（三）受理纸质材料

厦门市工业和信息化局装备和电子产业处

地 址：厦门市思明区湖滨北路61号市政府东楼620

咨询电话：2896758/2896779

五、其他事项

（一）申报单位或个人、财务审计机构在信用厦门平台无提示、警示信息，未列入失信联合惩戒范围，未出现涉黑涉恶问题。

（二）对于符合本政策支持条件，又符合其他市级资金政策的项目，补助资金按“就高不重复”原则办理。

附件：厦门市集成电路产业发展专项资金项目申报指南

厦门市集成电路产业发展工作领导小组办公室

（代）

2019年4月1日

（此件主动公开）

附件：

厦门市集成电路产业发展专项资金项目申报指南

本批重点支持三类项目：人才支持项目、科研支持项目、成长激励项目。企业申报项目，须根据以下要求提供相关材料：

一、基本材料

- （一）《厦门市集成电路产业发展专项资金申请表》（附件1）；
- （二）信用承诺书（附件2）；
- （三）项目申请报告；
- （四）企业营业执照复印件；
- （五）所从事的主营业务资质证明材料复印件：

（1）集成电路设计企业：EDA 正版软件使用证明、芯片设计版图缩略图、产品外观照片、流片证明（2017 年及 2018 年期间厦门市流片补贴资金下达文件或流片合同、流片发票）等相关佐证材料；

（2）集成电路制造企业：制造设备清单、2017 年及 2018 年度与客户签订的合同及收款发票复印件（若干）、生产车间及厂房照片等相关佐证材料；

（3）集成电路封测企业：封装测试设备清单、2017 年及 2018 年度与客户签订的合同及收款发票复印件（若干）、生产车间及厂房照片等相关佐证材料；

（4）集成电路装备和材料生产及研发企业：装备、材料清单及

说明，生产研发设备清单、2017年及2018年度与客户签订的合同及收款发票复印件（若干）、生产车间及厂房照片等相关佐证材料；

（5）化合物半导体器件制造、模块、外延片生产项目企业，微机电系统（MEMS）、功率半导体和特色工艺项目企业：设备清单、2017年及2018年度与客户签订的合同及收款发票复印件（若干）、生产车间及厂房照片等相关佐证材料；

（6）从集成电路公共技术服务企业：软件及设备清单、2017年及2018年度与客户签订的合同及收费发票复印件（若干）、软件及设备环境照片等相关佐证材料；

（六）2017年、2018年度经注册会计师审计的企业财务报表复印件，2017年、2018年度企业完税证明复印件；

二、申报项目

第一类 人才支持项目

（一）集成电路企业（单位）高管和技术团队核心成员奖励项目

1. 奖励对象：

在厦门市集成电路企业中担任高管和技术团队核心成员，年薪（税前）30万元（含）以上的。

2. 奖励标准：

按人才工资薪金所得三年内缴纳个人所得税地方留成部分的25%予以奖励，用于人才在厦购（租）房、购车、装修、家具家电购置、培训、未成年子女教育方面的消费支出。

3. 申报材料:

(1) 集成电路企业(单位)高管和技术团队核心成员奖励项目申请表(附件3);

(2) 申请人员身份证(境外人员提供护照、台胞证等有效身份证件)、劳动合同等复印件。高管需提供任职证明,技术团队核心成员需提供团队成员名单及相关履历;

(3) 按照完整年度(2018年1月-12月)提供工资薪金收入个人所得税明细申报情况清单;

备注:1.本项支持2018年1月1日-2018年12月31日期间缴纳的个人所得税地方留成部分。

2、高管是指董事长、总裁、总经理、CEO、副董事长、副总经理、总工程师、首席科学家、CTO、CIO等副总级(含)以上级别。

3.申请人员需留存在厦购(租)房、购车、装修、家具家电购置、培训、未成年子女教育方面的消费支出的票据等相关凭证备查,申报时不需提供。

4.已享受《关于进一步激励人才创新创业的若干意见》(厦委发〔2016〕4号)、《关于深化人才发展体制机制改革加快推进人才强市战略的意见》(厦委发〔2017〕16号)个税奖励的不能重复申报。

(二) 集成电路产业相关紧缺专业毕业生安家(租房)补助

1. 补助对象:

厦府〔2016〕220号文件实施之日起新接收的、具有全日制本科及以上学历、专业符合《厦门市集成电路产业相关紧缺专业目录》(附

件4)、与我市集成电路产业相关企业签订2年以上(含2年)的劳动合同且按规定缴纳社会保险金半年以上的毕业生。

2. 补助标准:

各类毕业生来厦集成电路企业就业安家(租房)补助标准如下:

毕业生安家补助标准 租房补助标准

本科生 800 元/月 400 元/月

硕士生 1200 元/月 600 元/月

博士生 2000 元/月 1000 元/月

3. 申报要求

(1) 我市集成电路企业在职在岗人员(不含实习人员)。

(2) 未享受过厦门市公租房、保障房或人才购房补助。

(3) 毕业生安家(租房)补助由企业(单位)统一申报,集成电路企业(单位)每年度新增享受补助的学生总数不高于当年企业员工总数的15%。

(4) 每名毕业生享受补助期限2年。

4. 申报材料:

(1) 集成电路产业相关紧缺专业毕业生安家(租房)补助申请表(附件5);

(2) 申请人员身份证(境外人员提供护照、台胞证等有效身份证件)、毕业证书、学位证书、劳动合同复印件,个人社保缴纳证明;

(3) 2018年度集成电路企业在职员工花名册(附件6)、地税

部门提供的单位社保缴纳证明(以申报年度12月份缴纳社保为准)。

备注:1.本项目支持2018年1月1日-2018年12月31日期间在职在岗的。

2.毕业生是指2018年度毕业,且于当年入职,目前仍在职的。

3.申请租房补助的毕业生须本人在厦无房产。

4.安家、租房补助可一起申请,也可申请其中一项。

5.已享受《关于进一步激励人才创新创业的若干意见》(厦委发〔2016〕4号)、《关于深化人才发展体制机制改革加快推进人才强市战略的意见》(厦委发〔2017〕16号)、《厦门市软件和信息服务业人才计划暂行办法》(厦经信软件〔2018〕33号)、《关于全面推进大众创业万众创新创建小微企业创业创新基地示范城市的实施意见》(厦府〔2017〕277号)安家、生活、租房补贴补助的,不能重复申报本项补助。

第二类 科研支持项目

(三) 微电子领域人才培养基地补助

1.奖励对象

(1)经认定为市级产业技工培养基地的集成电路企业(单位)、国内外重点高校、科研院所。

(2)经市里认定为示范性公共实训基地的集成电路企业(单位)、国内外重点高校、科研院所。

2.奖励标准

(1)经认定为市级产业技工培养基地的,给予每个基地不少于

50 万元补助。

(2) 经市里认定为示范性公共实训基地的，按照基地购置设备及装修费用的 30% 给予补助，单个基地最高补助 500 万元。

3. 申报材料：

(1) 产业技工培养基地、示范性公共实训基地认定文件复印件。

(2) 申请示范性公共实训基地的，需提供项目专项审计报告，购置设备及装修合同、发票及银行支付凭证复印件。

(3) 微电子领域人才培养基地补助汇总表（附件 7）

（四）获得国家支持的集成电路项目配套补助

1. 奖励对象

由 IC 领导小组成员单位推荐申报并获得国家重大科技专项、重点研发计划、重大科技成果转化项目等资金支持的集成电路类项目。

2. 奖励标准

符合上述条件的项目，给予 50% 的配套支持，额度超过 1000 万元，按 1000 万元予以补助，国家、省、市资助金额之和不超过项目总投资。国家有规定的，按规定执行。

3. 申报材料：

(1) IC 领导小组成员单位推荐文件、国家部委批复文件等复印件；

(2) 项目申报、立项的相关材料。

(3) 获得国家支持的集成电路项目配套补助项目汇总表（附件 8）

（五）高水平集成电路研发机构认定奖励

1.奖励对象

获批国家级、省市级企业技术中心、工程技术研究中心及重点实验室的集成电路企业（单位）。

2.奖励标准

获批国家级企业技术中心、工程技术研究中心、重点实验室的，给予补足 1000 万元的奖励；获批省、市级企业技术中心、工程技术研究中心、重点实验室的，给予一次性 100 万元的奖励。

3.申报材料：

（1）国家级、省市级企业技术中心、工程技术研究中心、重点实验室认定文件复印件。

（2）高水平集成电路研发机构认定奖励项目汇总表（附件 9）

备注：1.工程技术研究中心包括工程技术研究中心（科技体系）、工程研究中心（发改体系）。

2.同一级别的不同类型研发机构只能享受一次奖励。

（六）用于研发的多项目晶圆（MPW）、工程片试流片补助

1.补助对象

厦门市注册的集成电路企业、高校和科研院所，申请补助的项目承担单位应具备下列条件：

（1）具有一定数量的 IC 设计人才队伍，拥有开发自主知识产权芯片产品的能力；

（2）无侵犯他人知识产权行为，能够提供使用合法 IC 设计软件

工具进行芯片开发的证明；

(3) 所研发的芯片产品应有较高的技术水平，市场竞争力强，具备产业化前景。

2. 补助标准

优先支持产、学、研联合研发的芯片产品，主要采用无偿资助方式补助新研发芯片产品的初次试流片：

(1) 用于研发的集成电路企业 MPW，按照不高于 MPW 直接费用 70% 进行资助，用于研发的集成电路企业工程片试流片按照不高于其加工费 30% 进行资助。此外，针对先进工艺补助比例为：

工艺要求	MPW 补助比例	工程片试流片补助比例
硅 CMOS 工艺最小线宽 $\leq 55\text{nm}$ ； GaAs MMIC：工艺最小线宽 $\leq 250\text{nm}$ 。	80%	40%

(2) 用于研发的 MPW，高校或科研单位按照不高于 MPW 直接费用 80% 的额度进行资助。

(3) 每个企业（单位）年度补助总额不超过 200 万元。

2. 申报材料：

(1) 厦门集成电路设计流片补助资金申请表（附件 10）；

(2) MPW、工程片试流片补助项目资金汇总表（附件 11）；

(3) 项目研发说明（包括产品类型、产品概述、产品技术先进性、产品经济效益）等；

(4) 芯片版图缩略图（需用彩印）、产品外观照片；

(5) 流片项目订单及合同、发票复印件、付款凭证（境外加工

的需提供报关单或委外加工证明)、正版软件使用证明;

(6) 2018年度集成电路企业在职员工花名册(附件6)。

备注:本项支持2018年7月1日至2018年12月31日(具体时间以流片的发票日期为准)期间发生的项目。

(七) 本地集成电路企业本地首次工程流片补助

1. 补助对象

厦门市注册的集成电路企业。

2. 补助标准

本地集成电路企业利用本地非本企业集成电路生产线流片,按首次工程流片费用(含IP授权或购置、掩膜版制作、流片等)的40%给予补助,年度补助总额不超过500万元。

3. 申报材料:

(1) 厦门集成电路设计流片补助资金申请表(附件10);

(2) 本地首次工程流片补助项目资金汇总表(附件12);

(3) 项目研发说明(包括产品类型、产品概述、产品技术先进性、产品经济效益)等;

(4) 芯片版图缩略图(需用彩印)、产品外观照片;

(5) 流片项目订单及合同、发票复印件、付款凭证、正版软件使用证明;

(6) 2018年度集成电路企业在职员工花名册(附件6)

(八) IP 购买补助

1. 补助对象

购买 IP 用于本企业开展高端芯片研发，且具有独立法人资格的集成电路企业（单位）。

2. 补助标准

给予符合条件的企业 IP 购买直接费用 40% 的补助，单个企业（单位）每年补助总额不超过 200 万元。

3. 申报条件

（1）提供方应为专业 IP 供应商或晶圆代工厂，且成立三年以上，即 2016 年 3 月之前成立；

（2）申报单位应在 2017 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日期间（以完成知识产权登记变更或合同备案时间为准）与非关联单位签订转让或许可合同，且完成相关知识产权登记变更或合同备案。

4. 申报材料

（1）厦门集成电路企业 IP 购买补助申请表（附件 13）；

（2）2017-2018 年 IP 购买补助资金汇总表（附件 14）；

（3）知识产权登记备案等相关佐证材料，企业购买的 IP 已经或正在实施转化运作的佐证材料（完成试流片或工程流片）；

（4）IP 转让或许可合同、发票复印件及银行支付凭证；

（5）双方签章的非关联声明（提供方与购买方应为非关联关系）；

（6）2018 年度集成电路企业在职员工花名册（附件 6）。

备注：不得与本地集成电路企业本地首次工程流片补助项目重复申请。

第三类 成长激励项目

(九) 采购本地生产芯片模组补助

1. 补助对象

采购本地企业芯片或模组用于生产系统（整机）、终端等产品的本地企业。

2. 补助标准

当年销售额 10 亿元以上的本地系统（整机）、终端企业采购本地集成电路企业芯片或模组的，对同一本地集成电路企业供应商的首批订单，按已支付实际采购金额（采购额）的 40% 给予本地系统（整机）、终端企业补助，单个企业年度补助总额不超过 350 万元，向关联企业的采购不计入资助核算采购费用总额。

3. 申报材料

(1) 专项审计报告（内容须包含但不限于 2017 年、2018 年销售收入情况，采购项目情况，系统终端首批销售情况等）；2017 年、2018 年度由市税务部门认可的，能够体现年度收入的佐证材料（如企业所得税汇算清缴签证报告等）；

(2) 芯片或模组应用在系统（整机）、终端上的相关佐证材料；

(3) 采购合同、发票及银行支付凭证复印件；

(4) 集成电路企业供应商从事集成电路设计业务的相关证明材料；

(5) 采购本地生产芯片模组补助项目汇总表（附件 15）。

(6) 双方签章的非关联声明（提供方与采购方应为非关联关

系)；

备注：申报项目不得与《厦门软件和信息服务业发展专项资金》采购本地芯片和系统解决方案补助项目重复。

(十) 产业园区研发、生产、办公用房租金补助

1. 补助对象

在本《实施细则》第四条中认定的产业园区内租用研发、生产或办公用房的本地集成电路企业（单位）。

2. 补助标准

自首租日起 5 年内，按照“先交后补”的形式，给予租金 50% 的补助，每家企业补助的建筑面积不超过 1000 平方米，年度补助总金额不超过 30 万元。

购买产业园区房产的企业不得申报。存在转租、合租、共用及已享受其他类似场地经营租金补助等情况的企业不得申报。

3. 申报材料

(1) 园区管理机构证明文件；

(2) 研发、生产、办公用房的产权证复印件；

(3) 租赁合同、发票及银行支付凭证复印件；

(4) 2017-2018 年产业园区研发、生产、办公用房租金补助项目汇总表（附件 16）

(5) 双方签章的非关联声明（产权方与租用方应为非关联关系）。

备注：申报项目不得与《厦门软件和信息服务业发展专项资金》

软件园三期研发楼租金补贴项目重复。

（十一）集成电路项目固定资产投资补助

1. 补助对象

对符合厦门用地规定的集成电路设计、制造、封测及装备和材料等项目，可在土地购置、办公场地等给予优先保障，并根据具体情况给予一定额度的固定资产投资补助。

2. 补助标准

（1）设备补助：按照企业年度实际设备（不包含配电设备）投资额的 10% 给予补助，补助金额超过 1000 万元的提请“一事一议”确定。

（2）电力稳压系统补助：我市集成电路企业为提高工厂配电质量自主投入电力稳压系统建设的 IC 晶圆制造、封装等项目，按照项目电力稳压系统投资额的 20% 给予一次性补助，补助金额超过 1000 万元的提请“一事一议”确定。

（3）无尘室装修补助：按照项目千级、百级及以上等级无尘室实际造价的 20% 给予补助，补助金额超过 500 万元的提请“一事一议”确定。

3. 申报条件

（1）固定资产投资额以项目支持期间已付款的发票为准；不支持实行“一企一策”的项目；同一项目，已获得设备补助、电力稳压系统补助、无尘室装修补助的，可根据“就高不重复”原则给予补差。

(2) 设备补助，项目在 2017 年 12 月 31 日已完工，设备投资额以 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日期间已完成的投资为准；

(3) 电力稳压系统补助，支持 2017 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日期间购买的，项目电压等级需达到 10kV（含）以上，电力稳压系统投资额须根据《电力稳压系统设备清单》（附件 21）进行测算。

4. 申报材料

(1) 申请设备补助的，需提供《集成电路固定资产投资设备补助项目基本情况表》（附件 17）、《集成电路固定资产投资补助项目汇总表》（附件 18 表一）、根据项目专项审计报告提纲和要求（附件 19）撰写专项审计报告、设备补助项目信息表（附件 20）；项目合同、发票及银行支付凭证复印件；项目备案或核准文件、用地预审意见（土地房屋权证）、环境影响评价批复意见、规划选址意见等文件复印件。

(2) 申请电力稳压系统补助的，需提供《集成电路固定资产投资补助项目汇总表》（附件 18 表二）、根据项目专项审计报告提纲和要求（附件 19）撰写专项审计报告、项目合同、发票及银行支付凭证复印件；用地预审意见（土地房屋权证）等文件复印件。

(3) 申请无尘室装修补助的，需提供《集成电路固定资产投资补助项目汇总表》（附件 18 表三）、据项目专项审计报告提纲和要求（附件 19）撰写专项审计报告、项目合同、发票及银行支付凭证复印件；以及项目备案或核准文件、用地预审意见（土地房屋权证）、规划选址意见、验收报告等文件复印件。

（十二）集成电路企业增产奖励

1. 奖励对象

（1）年度销售收入首次超过 1 亿元、3 亿元、5 亿元、10 亿元的集成电路企业（不包括集成电路设计企业）。

（2）年度销售收入首次超过 2000 万元、5000 万元、8000 万元、1 亿元的集成电路设计企业。

2. 奖励标准

（1）本地集成电路企业（集成电路设计企业除外）收入首次超过 1 亿元、3 亿元、5 亿元、10 亿元的，自当年度起，连续 3 年将其新增增值税、企业所得税地方留成部分，分别按照 50%、40%、30%、20%的比例，总额不超过 500 万元的标准奖励企业。

（2）本地集成电路设计企业年度销售额首次超过 2000 万元、5000 万元、8000 万元、1 亿元的，自当年度起，连续 3 年将其新增增值税、企业所得税地方留成部分，分别按照 50%、40%、30%、20%的比例，总额不超过 500 万元的标准奖励企业。

（3）企业每次上升奖励级别奖励标准相应提升，奖励年限重新核计 3 年。

3. 申报条件

（1）2017 年或 2018 年度销售收入首次超过规定档次的给予相应奖励。

（2）对 2017 年或 2018 年度销售收入首次超过规定档次的，本期末提出申请的，视同放弃，此后不再给予同档次相应奖励。

(3) 企业自初次申请起 3 年度内销售收入出现下降，即不再享受相应档次奖励。

4. 申报材料

(1) 专项审计报告（内容须包含但不限于 2015-2018 年度销售收入，增值税、企业所得税等情况）、企业所得税汇算清缴签证报告；

(2) 2016 年、2017 年、2018 年企业增值税、企业所得税纳税申报明细；

(3) 集成电路企业增产奖励汇总表（附件 22）。

三、材料编制要求

(一) 项目申请报告主要内容

1. 项目申报单位概况：单位基本情况、产品、技术、设备、上下游供应商及客户合作关系等。

2. 项目主要内容：项目基本情况，建设内容。

3. 经济和社会效益分析（对技术、企业、产业发展作用的分析）。

(二) 纸质材料编制要求

按照基本材料、申报项目材料顺序编制、装订：

(1) 基本材料：《厦门市集成电路产业发展专项资金申请表》、信用承诺书、项目申请报告、所从事的主营业务资质证明材料复印件、年度企业财务报表复印件、年度企业完税证明复印件。

(2) 申报项目材料：项目申请表或汇总表等相关表格、认定文件、专项审计报告、合同、发票、银行支付凭证等复印件。

（三）装订须知

纸质材料纸皮胶装，材料侧面标注企业名称。纸质材料须加注目录、页码，基本材料与申报项目材料用彩页隔开。纸质材料一律用 A4 纸打印或复印清楚，尽量采用双面打印，申请表、申请报告、相关复印件须加盖单位公章。整份材料加盖骑缝章。